

JEITA LPB-SC LPB_Workshop2023TG

活動報告

半導体&システム開発技術サブコミッティ
SSD-SC



ワークショップ活動スケジュール

準備期間約2か月

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
SSD-SC	▲(5/26)		▲(7/21)		▲(9/15)			▲(11/21)		▲(1/26)		▲(3/12)
LPB/SDF WG	▲(5/24)		▲(7/21)		▲(9/15)			▲(11/21)		▲(1/26)		▲(3/12)
ライブラリTG	▲(5/12)		▲(7/7)	▲(8/4・8/10)		▲(10/6)	▲(11/10)	▲(12/8)			▲(2/2)	(4/5)▲
イベント					▲(9/1) LPB ワークショップ 2023			▲(11/27) JEVeC DAY2023				▲(3/1) 第16回フォーラム
■ イベント 実施方法検討			→									
プログラム検討			→									
資料準備				→								
資料事前公開					→	▲(9/1 13:00-)						
リハーサル? 実施方法決定					→	▲(9/x)						
Webページ作成・管理				→	▲(8/9)							
申込ページ作成				→	▲(8/9)							
アンケート内容検討				→								
アンケート準備					→	▲(9/1)						
												▲登録者に接続先連絡(8/31)
												▲お礼+アンケート依頼(9/4)
												▲報告(10/6)
■ 広報												
												▲(7月イベント告知)
												▲(8月Web予約開始 18頃配置)
												メルマガ広報+開催の内容を 小林
												▲(9月プログラムの概要を配信)
												▲(9月講演資料公開)

LPBワークショップ2023TG

- TGLーダ： サブリーダ：
- 日時：2023年9月1日(金)13:00～17:00
- 場所：JEITA 403会議室(10:00～18:00まで借用)
- 開催方法：Hybrid
- 参加者
 - 会場参加者：19人(委員)、5名(委員外)
 - オンライン参加者：13名
 - 懇親会参加者：14人(委員)、3人(委員外)、+JEITA
- 費用（審議案件） ←全件承認済（SSD-SC：9/15）
 - 会議室：123,000円(税別)
 - ペットボトルのお茶代（24本）：2,370円
 - コーヒー代ポット（3本）：7,801円
 - 懇親会（3,000円を会費として収集し、残りを委員会費用で対応）：19,777円

領 収 証

No. 4577800120
2023年09月01日

JEITA 様

〒2,370- (内消費税 ¥176-)

併し、お品代として上記正に領収いたしました。

印刷税申告納
付につき王子
税務署承認済

株式会社 カクヤス
東京都北区豊島2-3-1
TEL: 0120-109-158

※本票保管上のお願い 財布等にはさんで保管していただく
場合は印字面を内側に折って保管願います。 担当: 神瀬 悠正
※上記領収証には非課税商品が含まれる場合があります。



領収証

JEITA 様

タリーズコーヒー
大手町パークビルディング店
TEL: 03-6206-3095
FAX: 03-6206-3095

2023年09月01日(金) 14時31分40秒

領収金額 ¥7,801
(含む消費税 ¥577)

(お支払内訳)
現金 ¥7,801

併し、コーヒー代として

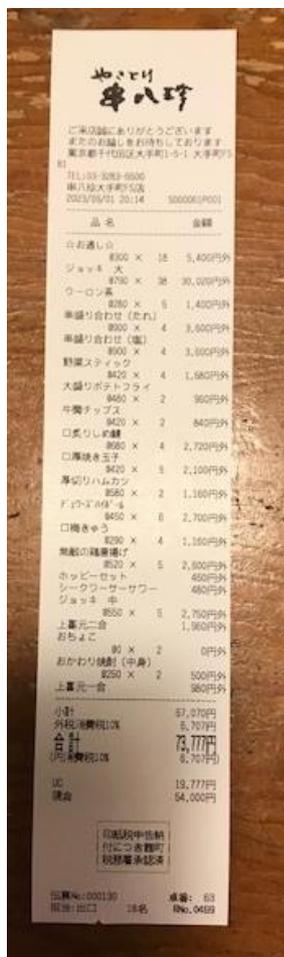
上記、正に領収いたしました

担当

※本票管理上のお願い
財布、手帳等に挟んで保管
頂く場合は、印刷面を内側
に折るようお願い致します
No:02-282455 担当者: 743680

< 領収証明細 >

* お* 付* 封* 装* フ* ラ* ッ*



LPBワークショップ 2023 9月1日 懇親会費
 合計金額 (レシート写真) : 73,777円
 会費3,000×18 = 54,000円
差額領収書 (委員会費) : 19,777円



LPBワークショップ2023TG

・LPBワークショップ2023

リーダー：村岡

日時：2023年9月1日(金)13:00～17:00

場所：Hybrid(JEITA 403会議室+Web)

プログラム内容：

テーマ	講演	時間
1. 開催にあたって	東芝デバイス&ストレージ(株)福場 義憲 氏	13:00-13:10 (10分)
2. EDAのAI活用	日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 シーメンスEDAジャパン(株) (株)図研 藤田陽子 氏	13:10-14:10(60分)
3. フロントローディング (まずはSI/PIから+EMCへ)	システムフロントローディングWG	14:10-15:25(75分)
4. 休憩		15:25-15:40(15分)
5. フロントローディング (LPBフォーマット拡張)	LPB相互設計・認証WG	15:40-16:55(75分)
6. 閉会の挨拶・連絡事項	司会	16:55-17:00(5分)

LPBワークショップ2023TG

LPBワークショップ準備

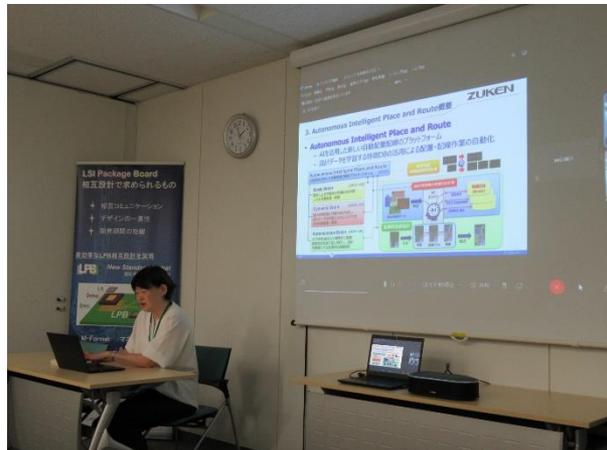
前日までの対応

- ・参加者名簿：JEITA
- ・名札/名札ケース：JEITA
- ・アンケート：JEITA
- ・お茶(ペットボトル：24本)：JEITA
- ・休憩時のコーヒー：JEITA
- ・横断幕/自立型バナー：JEITA
- ・カメラ：JEITA
- ・プロジェクト：JEITA
- ・ハイブリッド開催機器：JEITA
- ・懇親会予約：委員

当日対応

- ・受付：全員
- ・机のセッティング：全員
- ・質問のマイク係：設置マイクで対応
- ・写真：JEITA
- ・司会：委員
- ・Hybrid環境のセッティング：JEITA

LPBワークショップ2023TG



資料公開ページ

公開済

The screenshot shows the JEITA website interface. At the top, there is a navigation bar with the JEITA logo and the text 'JEITA 半導体&システム設計技術委員会'. Below this is a search bar and a menu with items like 'ホーム', 'お知らせ', 'LPBフォーマット公開情報', '委員会活動', '公開資料', 'お問合せ', and 'サイトマップ'. The main content area is titled '20230901 LPB workshop 2023 資料' and contains a section for '講演資料' (Lecture Materials) with 9/19 materials listed. The materials include 'EDAのAI活用' (AI Utilization in EDA) with sub-items for '日本ケイデンス・デザイン・システムズ社の取り組み' (JEDEC's efforts), 'シーメンスEDAジャパン(株)の取り組み' (Siemens EDA Japan's efforts), and '(株) 図研の取り組み' (Kogaku's efforts). Another material is 'フロントローディング(まずはSI/PIから+EMCへ)' (Front Loading) with sub-items for 'はじめに:本Workshopの狙い' (Introduction: Purpose of the workshop), 'Signal IntegrityとPower Integrityの検討をフロントローディングするための要件を考察する' (Examining requirements for front-loading SI and PI), and '開発手法としてMBSEに期待すること' (Expectations for MBSE as a development method). The page also features a 'システムフロントローディングWG' (System Front Loading WG) section and a footer with copyright information and a 'Translate' button.

日本語

検索

ホーム お知らせ LPBフォーマット公開情報 委員会活動 公開資料 お問合せ サイトマップ

リンク メールマガジン

20230901 LPB workshop 2023 資料

講演資料

9/19 全資料掲載

- EDAのAI活用
 - [日本ケイデンス・デザイン・システムズ社の取り組み](#)
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
 - [シーメンスEDAジャパン\(株\)の取り組み](#)
シーメンスEDAジャパン(株)
 - [\(株\) 図研の取り組み](#)
(株) 図研
- フロントローディング(まずはSI/PIから+EMCへ)
 - [1. はじめに:本Workshopの狙い](#)
 - [2. Signal IntegrityとPower Integrityの検討をフロントローディングするための要件を考察する](#)
 - [3. 開発手法としてMBSEに期待すること](#)

システムフロントローディングWG

- フロントローディング(LPフォーマット拡張) [公開資料なし]
LPB相互設計・認証WG

© 2019 JEITA SDTC, All Rights Reserved

[ログイン](#)

[Translate »](#)

アンケート実施方法・回答数

- ・今回もJEITAのアンケートシステムを使用。
- ・今回の回答率は、62%で過去最高。
- ・参加者は37名と少な目。
- ・前回に続いてリアル+リモートのハイブリッドで開催。24名のリアル参加があった。

	回答数	参加者	回答率
第12回LPB Forum	28名	73名	38%
第13回LPB Forum	36名	69名	52%
LPBワークショップ2022	18名	43名	42%
LPBフォーラム2022	30名	51名	59%
LPBワークショップ2023	23名 (9/15)	37名	62%

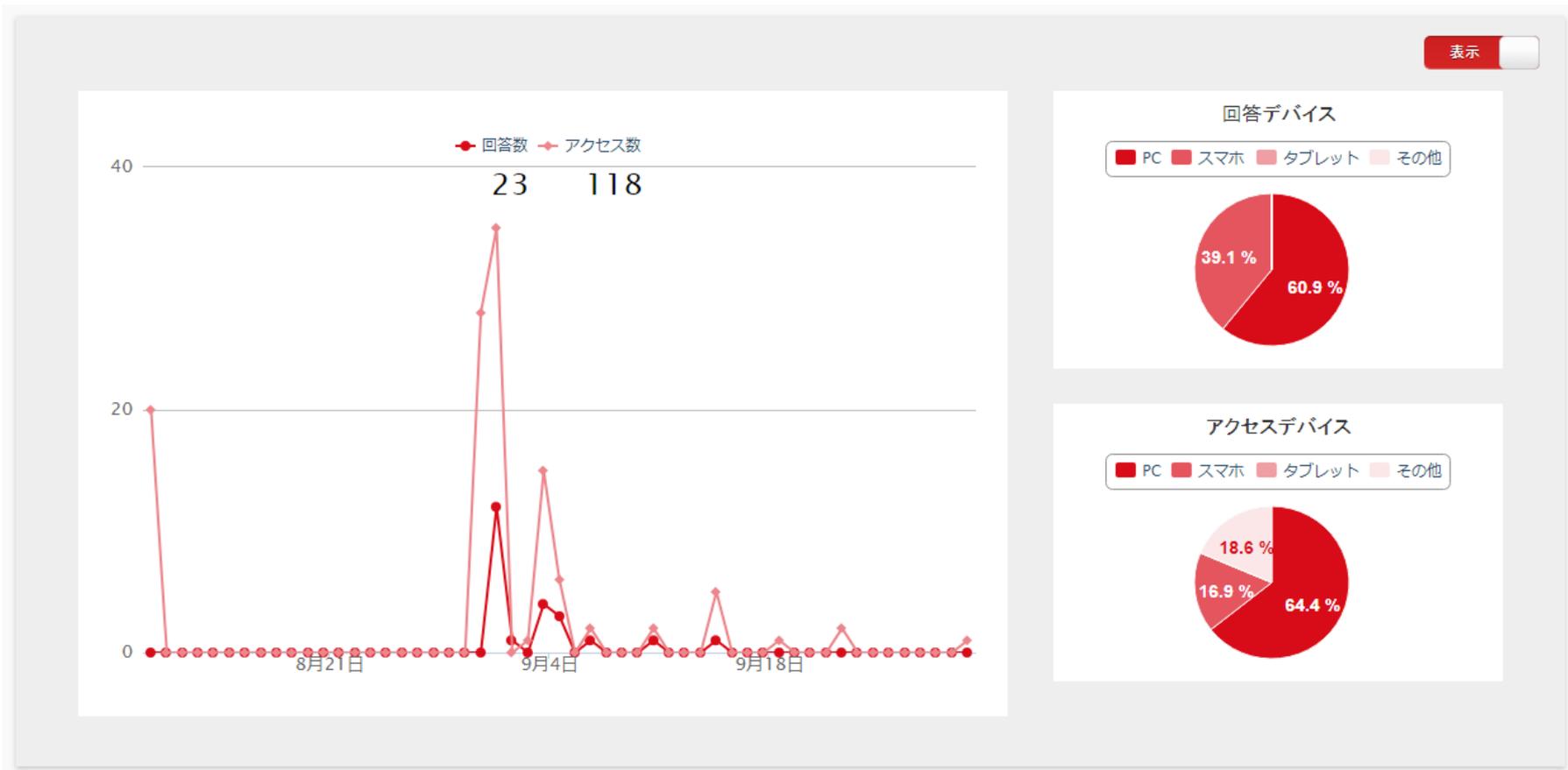
LPBワークショップ2023振り返り

キーワード	コメント
Webex events	<ul style="list-style-type: none">・今回はJEITA 403会議室 + webで開催。・質疑応答も含め今回は会場内の設置マイクで対応。リモート参加の方からも特に聞き取り難いとの声もなかった。前回は質疑応答にハンドマイクを使ったためリモート参加の方からは聞き取り難いとの声も有ったが、今回は改善されている。・web参加の方からは、画面が固まったり、音声途切れたりといった声は無かった。・
アンケート	<ul style="list-style-type: none">・今回もJEITAのシステムを利用。作成の手間が無いのは良い。・今回の回答率は62%と過去最高。・今のところ社内環境からアクセスできなかったという声は無かった。・アンケートシステムに違和感は無かった。使いやすい・フォーラムとワークショップで各々に傾向が有るようなので、前回との比較はフォーラム同士、ワークショップ同士でした方が良いかも。・
会場	<ul style="list-style-type: none">・今回はJEITAの会議室を確保出来た。今年度からJEITAの会議室も費用が発生するが設備の設置等の使い勝手を考えるとメリットは有る。・JEITAの会議室も費用が発生するので、外部の安いところを探すという選択肢もあるかも。・上納金が少なくなっているので、可能であればJEITAの会議室を使う方針。・JEITAの会議室は机の並び替えが必要になるので、それも準備項目にいれておいた方が良い。

LPBワークショップ2023振り返り

キーワード	コメント
リハーサル	<ul style="list-style-type: none">・映像や音声のチェック以外は特に行わなかった。今回はブレイクアウトセッション等使わなかったため、特に問題無かった。・
当日の配信について	<ul style="list-style-type: none">・大きなトラブルなく配信出来た。運営はうまくいったと思う。・
発表者	<ul style="list-style-type: none">・プレゼン資料もWEB共有したものをスクリーンに映したので特に大きな問題は無かった。・やはり顔が見える状態の方が進行もし易い。・
公開資料のURL	<ul style="list-style-type: none">・前回同様に今回も事前に資料を公開しなかった。・資料公開のタイミングがまちまちなので、HPに間に合わない分は「残りは準備中」と記載。・お礼メールには資料の掲載状況を明記 & 「全掲載後にメルマガでお知らせ」と記載。・上記の対応で、公開資料については特に問合せ等は無かった。・どのタイミングで何を広報するかを決めてスケジュールリングして対応した方が良い。

アンケート内容



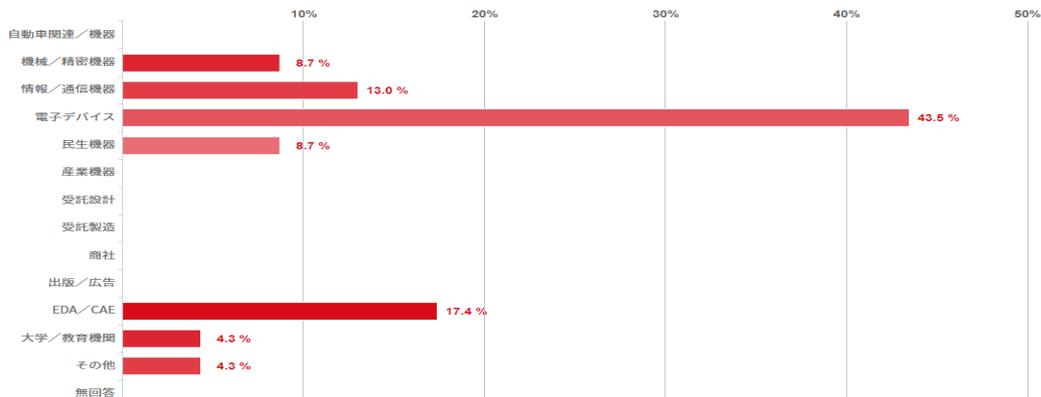
前回は「スマホ」のアクセス(24%)回答(50%)となり前々回から大幅に増加したが、今回はPCが2/3を占めた。当日回答が多かったためと思われる。

アンケート内容

Q2.

あなたの業種について(1つお選びください)
(回答数: 23)

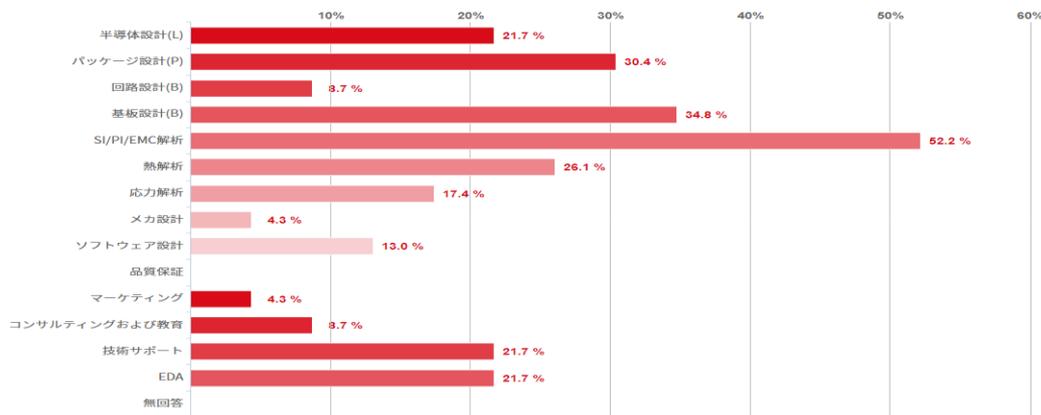
従来同様に「電子デバイス」・「EDA/CAE」が多いが、前回7%だった「自動車関連」の参加は今回は無かった。



Q3.

あなたの職種について(該当するものをすべてお選びください)
(回答数: 23)

従来通り「SI/PI/EMC解析」の割合が高い。前回と比較すると「回路設計」の割合が17%→8.7%に減少している。

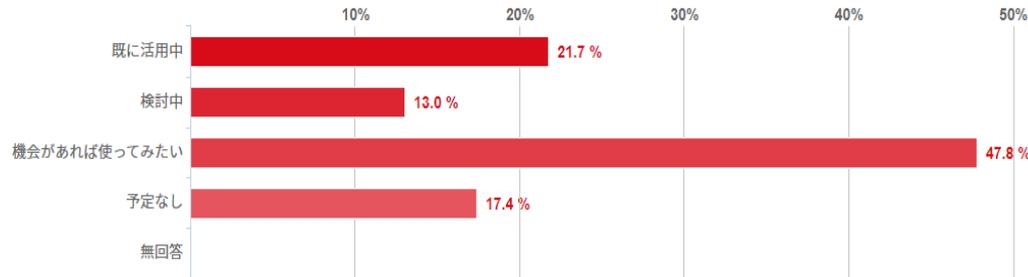


アンケート内容

Q4.

あなたのLPBフォーマット活用状況について(1つお選びください)
(回答数: 23)

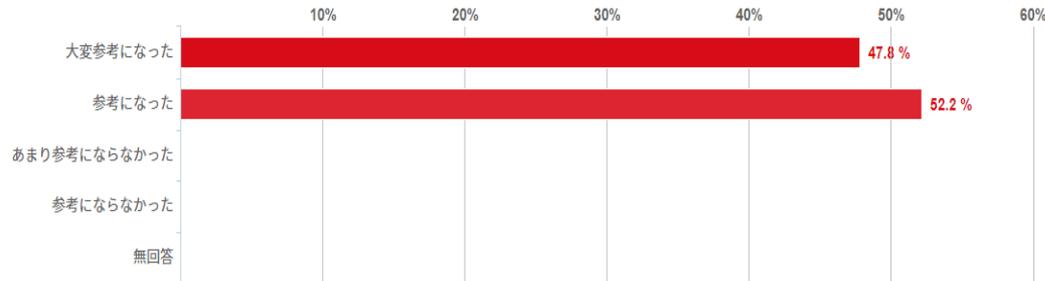
前回と比較すると「既に活用中」が33%→22%へ減少したが、「機会があれば使ってみたい」が37%→48%に増加。



Q5.

本ワークショップ全般について(1つお選びください)
(回答数: 23)

前回と比較すると「大変参考になった」が77%→48%に減少したが、全ての方が「大変参考になった」と「参考になった」と回答。



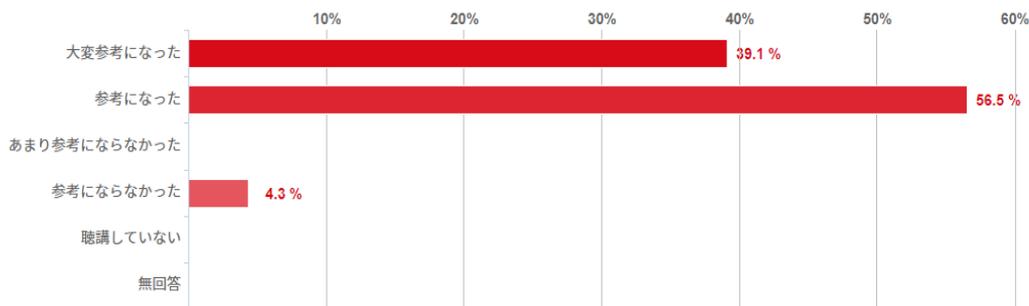
アンケート内容

Q6.

EDAのAI活用ついて(1つお選びください)

(回答数: 23)

「参考になった」との意見が多い。

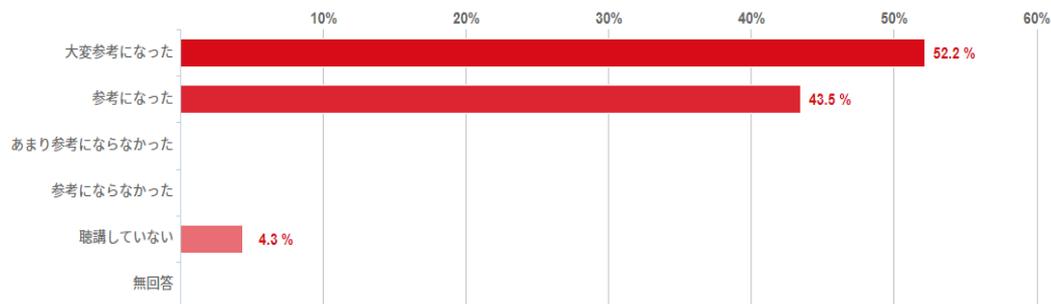


Q7.

フロントローディング(まずはSI/PIから+EMCへ)について(1つお選びください)

(回答数: 23)

「大変参考になった」との意見が多い。

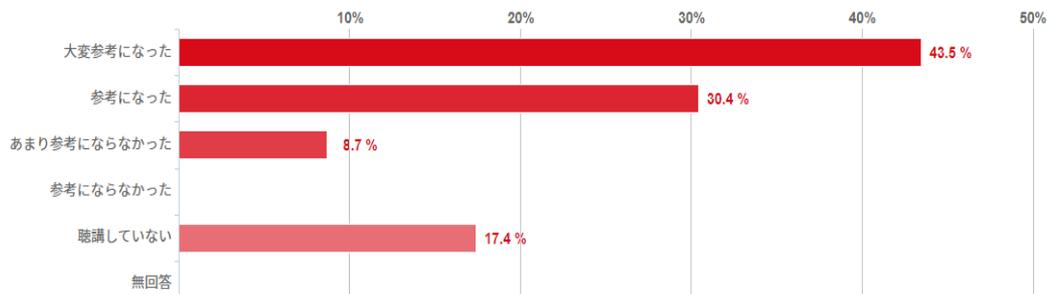


アンケート内容

Q8.

フロントローディング（LPBフォーマット拡張）について(1つお選びください)
(回答数: 23)

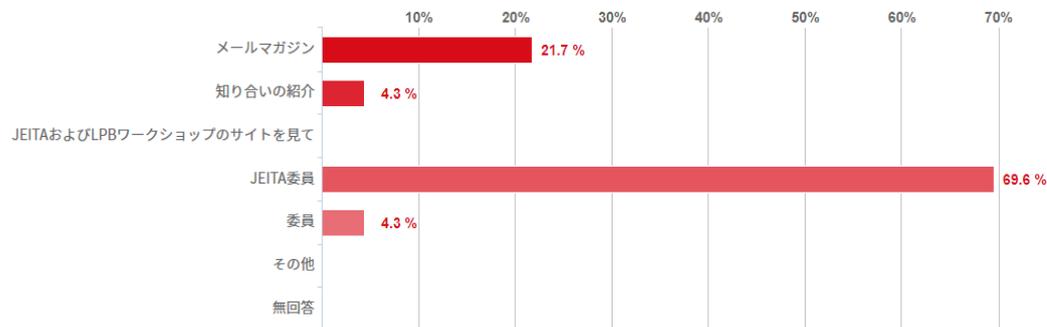
「大変参考になった」との意見が多い。



Q9.

本ワークショップはどこで知りましたか?(1つお選びください)
(回答数: 23)

例年通り「JEITA委員」と「メールマガジン」で全体の9割を占める。



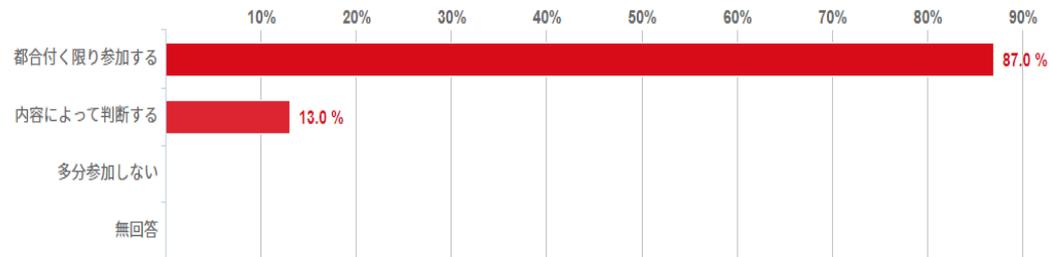
アンケート内容

Q10.

次回も参加したいですか？(1つお選びください)

(回答数: 23)

継続して参加を希望する意見が多い。



アンケート内容

Q11.

LPBワークショップでディスカッションしたい内容はありますか？ご自由にお書きください

(回答数: 5 無回答: 18)

1

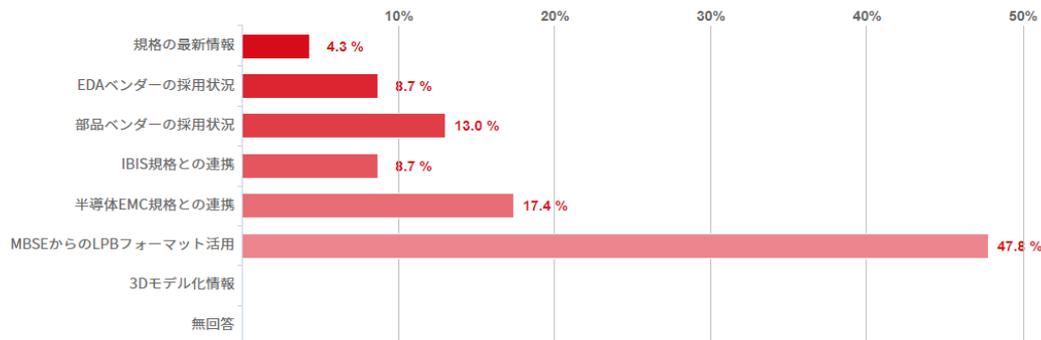
グループ	回答	性別	年齢
+グループ化	協調設計	無回答	無回答
+グループ化	効果的な事例での討議	無回答	無回答
+グループ化	MBSEの掘り下げ、MBD対応設計環境	無回答	無回答
+グループ化	LPBフォーマットについて	無回答	無回答
+グループ化	LPBフォーマットおよびその粒度に対する要求を、実際の設計フローに合わせてくれるか？	無回答	無回答

アンケート内容

Q12.

次回何を上げて欲しいですか？(LPBフォーマットに関して1つお選びください)
(回答数: 23)

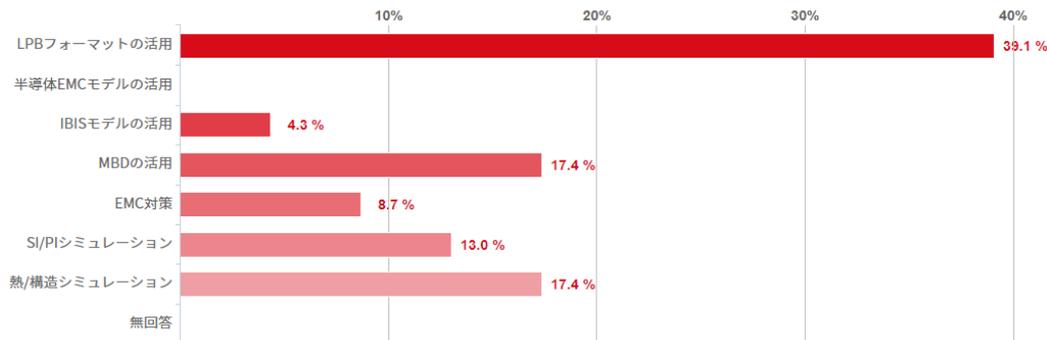
前回同様に「MBSEからのLPBフォーマット活用」について希望する意見が多かった。



Q13.

次回何を上げて欲しいですか？(活用事例に関して1つお選びください)
(回答数: 23)

「LPBフォーマットの活用事例」を希望する意見が多かった。

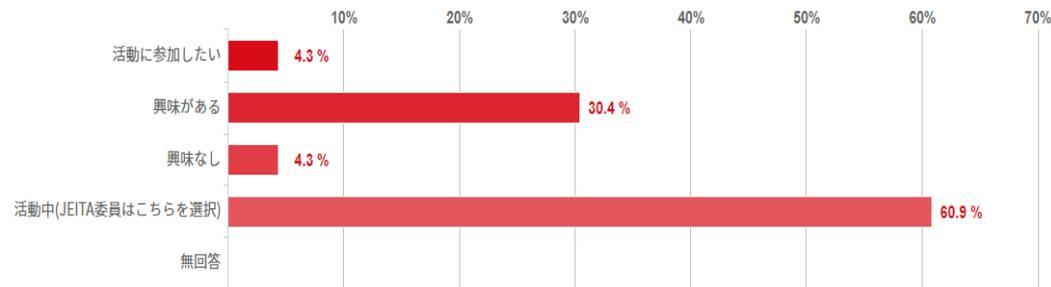


アンケート内容

Q14.

半導体&システム開発技術SCの活動に興味がありますか？(1つお選びください)

(回答数: 23)



アンケート内容

Q15.

本活動に期待する事、本ワークショップで興味あった内容、もっと詳しく知りたい内容などご自由にお書きください

(回答数: 4 無回答: 19)

1

グループ	回答	性別	年齢
+グループ化	PI協調設計のフロントローディング	無回答	無回答
+グループ化	MBSEでフロントローディング環境づくりの議論を続けてください	無回答	無回答
+グループ化	セットメーカーとLSIメーカーの製品開発において、最低限必要な情報共有について。	無回答	無回答
+グループ化	まずはSI/PIから、という内容を興味を持って聞かせていただきました。特に現状のPI解析の状況説明がとても現場をとらえてる感じが致しました。	無回答	無回答

アンケート内容

Q16.

Webでの開催についてご意見があればお願いします

ワークショップはリアル開催が良いという意見が多い。Webは参加し易いとの意見も有り、全体的にハイブリッド開催は支持されている。

(回答数: 6 無回答: 17)

[12 次へ](#)

グループ	回答	性別	年齢
+グループ化	ワークショップはリアルが良いとあらためて感じた。	無回答	無回答
+グループ化	都合がつけやすい	無回答	無回答
+グループ化	WSは現地参加がよいですね	無回答	無回答
+グループ化	是非次回もオンライン開催してほしい。	無回答	無回答
+グループ化	時間的・内容的に不足。箱根での開催の再開を希望する。	無回答	無回答

[前へ 12](#)

グループ	回答	性別	年齢
+グループ化	現地参加できない方もいらっしゃるのであった方がよいとは思いますが、リアルでの参加はより良いと思いました。	無回答	無回答